

# ディスペンス用ソルダペースト

## Solder paste for dispensing

### 印刷困難な立体形状や 2 次実装に対応

Supports three-dimensional shapes and secondary mounting that are difficult to print

### ジェットディスペンサータイプ : $\phi 200\mu\text{m}$ 以下の吐出を実現

Jet dispenser type: realization of dispensing less than  $\phi 200\mu\text{m}$ .

### エアディスペンサータイプ : $\phi 100\mu\text{m}$ の塗布及びレーザーによる加熱方式にも対応

Air dispensing type : capable of  $\phi 100\mu\text{m}$  dispensing or applicable for laser soldering.

## ジェットディスペンサー Solder paste for jet dispensing

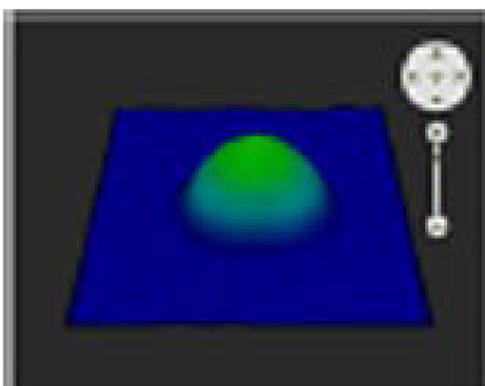
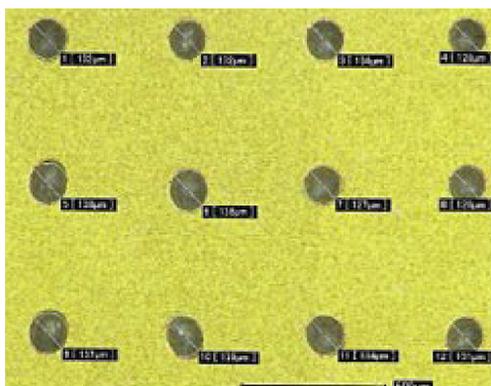
# winDot-F005-NP303

### ジェットディスペンサ塗布結果

Jet Dispensing Result

#### 塗布形状

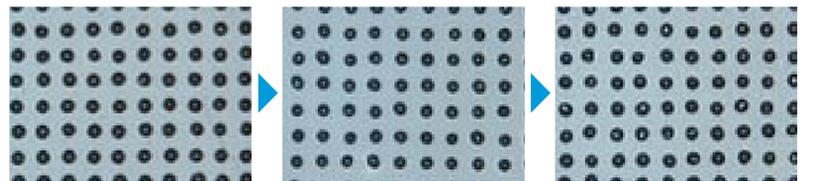
Dispensing shape



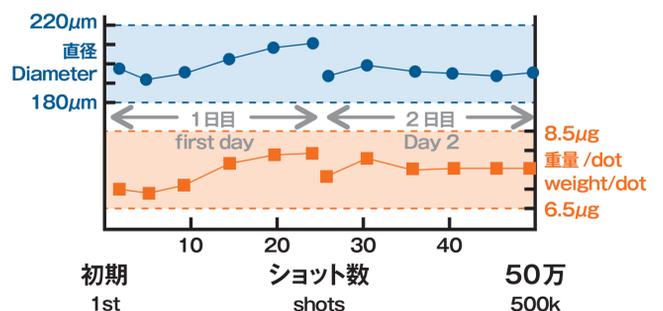
$\phi 200\mu\text{m}$  以下で塗布可能  
Can be applied at  $\phi 200\mu\text{m}$  or less

#### 連続塗布性能

Continuous dispense result



初期 1st Shot      30万ショット 300k shots      50万ショット 500k shots



## エアディスペンサー Solder paste for air dispensing

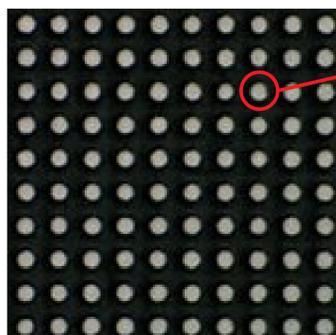
### 微小塗布対応品

Products for micro-diameter application

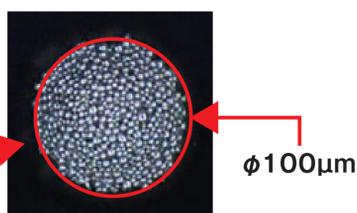
## NP303-DPF201-T7

#### 塗布形状

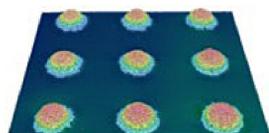
Dispensing shape



$\phi 100\mu\text{m}$  の安定塗布  
Stable application of  $\phi 100\mu\text{m}$



拡大  
Enlarge



3D 形状  
3D Shape

### レーザー加熱対応品

Products for laser soldering application

## NP303-DPS101-T4

#### レーザーはんだ付け例

Laser soldering example

従来品 Conventional products      NP303-DPS101-T4



レーザーによる急加熱に対応。  
ぬれが速く、ボールが非常に少ない。  
低融点 SB58 組成も対応。

Compatible with rapid heating by laser.  
Fast wetting and very few balls.  
Compatible with low melting point SB58 composition.

